III-V/Si MOS キャパシタマッハツェンダ変調器による 10 Gb/s 強度変調 10-Gb/s intensity modulation with III-V/Si MOS capacitor Mach-Zehnder modulator NTT 先端集積デバイス研¹, NTT ナノフォトニクスセンタ², ⁰開 達郎^{1,2}, 相原 卓磨¹, 長谷部 浩 -¹, 藤井 拓郎^{1,2}, 武田 浩司^{1,2}, 硴塚 孝明^{1,2}, 土澤 泰^{1,2}, 福田 浩^{1,2}, 松尾 慎治^{1,2} NTT Device Technology Labs.¹, NTT Nanophotonics Center², ^oTatsurou Hiraki^{1,2}, Takuma Aihara¹, Koichi Hasebe¹, Takuro Fujii^{1,2}, Koji Takeda^{1,2}, Takaaki Kakitsuka^{1,2}, Tai Tsuchizawa^{1,2}, Hiroshi

Fukuda^{1,2}, and Shinji Matsuo^{1,2}

E-mail: hiraki.tatsurou@lab.ntt.co.jp

1. 背景

光変調器の小型化、低コスト化に向けて、シリコ ン(Si)フォトニクス素子が注目されている。特に、Si metal-oxide-semiconductor (MOS)光変調器は $V_{\pi}L$ 低 減が容易であり、小型変調器として有望である。し かしその反面、大きな酸化膜容量により 3-dB帯域が 小さい点が課題となる。これに対し、電子による屈 折率変化がSiより大きく、電子移動度がSiより高い InP系材料をn型半導体として用いる III-V/Si MOS 光変調器は、小型でも容量と抵抗の低減が可能であ り、小型化と高速化の両立が可能となる [1,2]。先行 研究では、上記素子の静特性のみ示されたが、本研 究では動特性に関して報告する。

2. 設計

n型III-V族半導体として、InGaAsP($\lambda g = 1.3 \mu m$) と InP に注目する (図 1)。V_πL が等しく(0.15 Vcm) なるように酸化膜容量を設計した場合、MOS 光変調 器の 3-dB 帯域は直列抵抗、即ち、MOS 光変調器と 電極コンタクト間の長さに依存する。3-dB 帯域と変 調器-電極間長さの関係の計算結果を図 2 (a)に示す。 n型, p型半導体は共に変調器-電極間長さが同じとし た。III-V/Si MOS 変調器の 3-dB 帯域は従来の Si 変調 器より大きいことが分かる。この計算結果を元に、 本研究では、InP/Si マッハツェンダ変調器を作製し、 位相シフタ長は 700 μm 、変調器-電極間長さは 2.5 μm とした。V_π、3-dB 帯域の計算値はそれぞれ約 2 V、 約 3 GHz であり、プリエンファシス信号回路による 10 Gb/s 変調動作が可能となる。

3. 測定結果

測定では、ビットレート 10 Gb/s、non-return-to-zero、 pseudo-random binary sequence 2³¹-1の強度変調信号を pulse pattern generator (PPG)から出力し、19 dB のゲイ ンを与えてマッハツェンダ変調器に入力した。入力 信号のプリエンファシスにはポストカーサ(1 段)を 用いた。入力光は transverse electric モードとし、DC バイアスは-4 V とした。図2(b)にアイパターンの測 定結果を示す。10 Gb/s におけるアイ開口が確認でき た。なお、変調器-電極間長さを短くすることで、3-dB 帯域は20 GHz 以上まで向上し、ビットレートの更な る向上が可能となる。

4. まとめ

小型化と高速化が可能なIII-V/Si MOS 光変調器を 作製し、10 Gb/s 動作を確認した。これにより、Si フ ォトニクス素子の更なる高性能化の可能性を示した。

参考文献

[1] 開他, 第77回応物秋季, 14p-B4-1, 2016

[2] 韓他, 第77回応物秋季, 14p-B4-2, 2016



Figure 1 Schematic of III-V/Si MOS capacitor modulator



Figure 2 (a) Calculated bandwidth, (b) measured eye diagram